

御中

製品仕様書
Product specifications

製品名 Product Name	SFPコネクタ SFP Connector	
製品番号 Product Number	ターミナル Terminal	742766-2MAC
	ハウジング Housing	SFP79-02HG□□
		SFP79-02HGN□□
ウエハー Wafer	SFP79-02WLB□□	

受領印欄
Acknowledged

日本オートマチックマシン株式会社
電子部品事業部 製品技術G
〒146-0092 東京都大田区下丸子3-28-4
TEL 03(3756)1435
JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD
Product Engineering Group Electronic Parts
Headquarters
3-28-4, Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo 146-0092, Japan

※ RoHS対応品
This product corresponds to RoHS.

1. 適用範囲 (Scope)

この製品仕様書は「SFPコネクタ」の一般仕様及び性能について規定する。
The present document concerns general specifications and performances of "SFP connector".

2. 製品名・製品番号 (Product name and number)

製品名 Product Name	製品番号 Number	材料及び表面処理 Material and surface treatment
ソケット コンタクト Socket Contact	7 4 2 7 6 6 - 2 M A C	銅合金 スズメッキ材 Copper Alloy, Pre-tin plated 表面メッキ(Surface plating): Sn 0.8~2.0 μm
ハウジング Housing	S F P 7 9 - 0 2 H G □ □	ナイロン 6 6 (UL94 V-0) Nylon 66 (UL94 V-0)
	S F P 7 9 - 0 2 H G N □ □	
ウエハー DIPタイプ Wafer, DIP-type	S F P 7 9 - 0 2 W L B □ □	ベース: ナイロン 6 6 (UL94 V-0) GF入り 角ピン: 黄銅 スズメッキ Base: Nylon 66 (UL94 V-0) with GF Pin: brass, Tin plating

3. 形状・寸法・材料 (Geometry and materials)

添付図面による。
Refer to attached drawings.

図面番号 Drawing No.	製品名 Product name	記号 Mark
J C - 1 0 6 6 - 3 2	S F P コネクタ D I P タイプ SFP Connector DIP-type	0
J C - 1 0 6 6 - 3 3	S F P コネクタ D I P タイプ SFP Connector DIP-type	0
J C - 1 0 6 6 - 0 9	S F P ハウジング SFP Housing	△
J C - 1 0 6 6 - 3 4	S F P ハウジング SFP Housing	0
J C - 1 0 6 6 - 3 5	S F P ウエハー D I P タイプ SFP Wafer, DIP-type	0
J C - 1 0 6 6 - 1 1	ソケット コンタクト Socket Contact	0

4. 定格 (Rated values)

項目 Item	規格値 Description
定格電圧 Rated voltage	600V AC, DC 600 V AC, DC
定格電流 (注1) Rated current (Note 1)	10A
使用温度範囲 Temperature range	-25 ~ +85℃ (通電による温度上昇分を含む) -25 to +85℃ (heating by energization included)
適合電線 (注2) Permissible sized wire (Note 2)	AWG #16 ~ #20 最大被覆外径 φ3.3mm AWG #16 to #20 Maximum diameter of insulation covering φ3.3 mm
適用プリント基板 Applicable P.C. board	厚さ: 1.2mm、1.6mm 穴径: ボス側 φ2.1 ^{+0.1} ₋₀ mm 穴径: 角ピン側 φ1.7±0.05mm Thickness 1.2 mm, 1.6mm Hole diameter φ2.1 ^{+0.1} ₋₀ mm, Boss side Hole diameter φ1.7±0.05 mm, Pin side
保存温度 Storage temperature	-40 ~ +85℃ (70%RH以下) -40 to +85℃ (70% RH or less)

(注1) 定格電流はコンタクト接触部の定格値であり、実使用においては使用電線の定格電流、コネクタの極数、使用温度により決定される。

(注2) 電線はより線を使用し、単線等の特殊電線は原則として使用出来ません。

(Note 1) The rated current shown is at the terminal contact section. Practically, it varies depending on rated current of particular wire and operating temperature and poles.

(Note 2) Use a stranded wire. Do not use solid or other special wires.

5. 性能 (Performances)

性能は、下表に示す試験条件及び方法で試験を実施したとき、各項目に規定する規格値を満足すること。尚、試験は特に指定のない限り JIS C 60068-1 [環境試験方法 (電気、電子) 通則] に規定された試験場所の標準にて実施する。

The performances tested under the conditions and methods given in the table below shall conform to the respective specifications. Unless otherwise specified, carry out the tests according to the standards of a place of test stipulated in IEC 60068-1 "General Rules of Environmental Testing Method (Electric and Electronic)".

5-1 外観 (Appearance)

No.	項目 Item	規格値 Description	条件 Check
5-1-1	外観 Appearance	使用上有害となる様な割れ・変形等が無いこと Crack, deformation, etc. harmful in use are not allowed	目視 Visual

5-2 機械的性能 (Mechanical properties)

No.	項目 Item	規格値 Description		試験条件及び方法 Check
5-2-1	挿入力 Insertion force	初回 1st	20 N 以下 20 N or less	ターミナルをハウジングに装着し、ウエハーへの保持力、挿入力を万能試験機を用いて測定する。
5-2-2	保持力 Pull-out force	初回 1st	3 N 以上 3 N or more	試験速度 25 mm/min Using universal testing machine, Measure the force required for inserting the wafer into housing and the pull-out force of wafer at 25 mm/min.
		10回 10th	2 N 以上 2 N or more	
5-2-3	ターミナル 挿入力 Terminal insertion force	7 N 以下 7 N or less		ターミナルをハウジングに挿入するのに要する力を万能試験機を用いて測定する。 試験速度 25 mm/min Using universal testing machine, measure the force required for inserting the terminal into housing at 25 mm/min.
5-2-4	ターミナル 保持力 Terminal pull-out force	SFP79-02HG	30 N 以上 30 N or more	ハウジングに装着したターミナルを軸方向に引張り、ハウジングからターミナルが離脱するときの荷重を万能試験機を用いて測定する。 試験速度 25 mm/min Using universal testing machine, pull the terminal axially at 25 mm/min until it leaves the housing. Take the reading at this point.
		SFP79-02HGN	40 N 以上 40 N or more	
5-2-5	ハウジングロック 保持力 Engaging and separating force	SFP79-02HG	30 N 以上 30 N or more	ウエハーとハウジングを嵌合させ、ハウジングを引張り、ロックが外れるときの力を測定する。 試験速度 25 mm/min Engage the wafer and housing with each other, and pull the housing at 25 mm/min until unlocked. Take the reading at this point.
		SFP79-02HGN	40 N 以上 40 N or more	

No.	項目 Item	規格値 Description		試験条件及び方法 Check
5-2-6	圧着部引張強度 Crimp strength	電線 Wire size	強度 N 以上 Minimum strength in N	ターミナルのワイヤバレルと電線導体を圧着し、治具で固定し電線の軸方向に引っ張る。 試験速度 25mm/min Crimp the terminal's wire barrel and conductor together, fasten the altogether, and pull the wire axially at 25 mm/min
		AWG#16	120	
		AWG#18	80	
		AWG#20	65	
5-2-7	ウエハー 角ピン保持力 Wafer square pin pull-out force	30N 以上 30 N or more		ウエハーの角ピンを基板装着方向に押し出し、ウエハーから角ピンが離脱するまでの最大荷重を万能試験機を用いて測定する。 試験速度 25mm/min Using universal testing machine, Measure the pull-out force of square pin at 25 mm/min until it leaves the wafer. Take the reading at this point.

5-3 電氣的性能 (Electrical characteristics)

No.	項目 Item	規格値 Description		試験条件及び方法 Check
5-3-1	接触抵抗 Contact resistance	初期 10mΩ 以下 10 mΩ or less initially		コネクタを嵌合状態にして電気抵抗を測定し、電線抵抗を差し引いて接触抵抗とする。 試験電流 10mA (20mV以下) Engage the connector, measure the overall resistance at 10 mA and 20 mV or less and, from the reading, subtract the wire resistance. Retain the difference as contact resistance.
5-3-2	絶縁抵抗 Insulation resistance	1000MΩ 以上 1000 MΩ or more		コネクタ外面とターミナル相互間及び隣接するターミナル間にDC500Vを印可して測定する。 Apply 500 V DC between connector housing and each of terminals, and between adjacent terminals.

No.	項目 Item	規格値 Description	試験条件及び方法 Check
5-3-3	耐電圧 Dielectric strength	AC 1500V / 1分間 異常なきこと AC 1500V / 1min. Shall remain normal	ハウジング外面とターミナル相互間及び隣接するターミナル間にて測定する。 Apply 1500 V AC for 1 min between connector housing and each of terminals, and between adjacent terminals
5-3-4	温度上昇 Temperature rise	30 K 以下 (適用最大電線による) 30 K or less (With thickest applicable wire)	ハウジングの全極にターミナルを装着し、嵌合させて各ターミナルを直列に接続し、最大定格電流を通電した時のターミナル部の温度上昇を測定する。 Mount the terminals on all housing poles, engage them, connect all terminals in series, apply rated current, and measure the temperature at terminals

5-4 耐久環境性能 (Durability)

No.	項目 Item	規格値 Description	試験条件及び方法 Check
5-4-1	挿抜寿命 Engagement and disengagement	接触抵抗 Contact resistance	ハウジングにターミナルを装着し、ウエハーにハウジングを挿抜(30回)試験前後の接触抵抗を測定する。 Mount the terminals on housing, repeat 30 cycles of insertion and removal of housing into and from wafer, and measure the contact resistance
		外観 Appearance	
5-4-2	耐振動性 Vibration	接触抵抗 Contact resistance	コネクタを結合し、下記条件にて振動試験実施。 掃引割合 10~55~10Hz 掃引時間 1分 最大振幅 1.5 mm 振動軸方向 X、Y、Z 振動時間 各2時間=6時間 Engage the connector, and carry out tests under following conditions. Sweep frequency 10-55-10 Hz. Sweep time 1 min. Maximum amplitude 1.5 mm. Vibration axes X, Y, Z. Vibration time 2 h each or totally 6 h.
		電流瞬断 Momentary failure	
		外観 Appearance	

No.	項目 Item	規格値 Description		試験条件及び方法 Check
5-4-3	耐塩水噴霧性 Salt mist	接触抵抗	20mΩ 以下	コネクタを結合後、下記条件に放置 温度 35 ± 2℃ 塩水濃度 5 ± 1% (重量比) 噴霧時間 48時間 接触抵抗測定は、水洗をし室温で乾燥 させてから、1～2時間放置後測定。 Engage the connector, and keep the sample under following conditions. Temperature 35 ± 2℃. Salt concentration 5 ± 1%wt. Spray time 48 h. Then, rinse the sample, and leave it dry at room temperature for 1 to 2 h.
		Contact resistance	20 mΩ or less	
		絶縁抵抗	500MΩ 以上	
		Insulation resistance	500 MΩ or more	
		耐電圧	AC1000V/ 1分間 異常なきこと	
Dielectric strength	Shall remain normal at 1000 V AC for 1 min			
外観	異常なきこと			
Appearance	Shall remain normal			
5-4-4	耐湿性 Damp heat	接触抵抗	20mΩ 以下	コネクタを結合後、下記条件に放置 雰囲気温度 40 ± 2℃ 相対湿度 90～95% RH 放置時間 96時間 室内で1～2時間放置後測定 Engage the connector, and keep the sample for 96 h under following conditions. Ambient temperature 40 ± 2℃. Relative humidity 90 to 95%. Leave the sample at the room for 1 to 2 h before check.
		Contact resistance	20 mΩ or less	
		絶縁抵抗	500MΩ 以上	
		Insulation resistance	500 MΩ or more	
		耐電圧	AC1000V/ 1分間 異常なきこと	
Dielectric strength	Shall remain normal at 1000 V AC for 1 min			
外観	異常なきこと			
Appearance	Shall remain normal			

No.	項目 Item	規格値 Description		試験条件及び方法 Check
5-4-5	耐熱性 Dry heat	接触抵抗 Contact resistance	20mΩ 以下 20 mΩ or less	コネクタを結合後、下記条件に放置 雰囲気温度 125 ± 5℃ 放置時間 96時間 室内で1～2時間放置後測定 Engage the connector, and keep the sample for 96 h under following conditions. Ambient temperature 125 ± 5°C. Leave the sample at the room for 1 to 2 h before check.
		外観 Appearance	異常なきこと Shall remain normal	
5-4-6	耐寒性 Cold	接触抵抗 Contact resistance	20mΩ 以下 20 mΩ or less	コネクタを結合後、下記条件に放置 雰囲気温度 -40 ± 3℃ 放置時間 48時間 室内で1～2時間放置後測定 Engage the connector, and keep the sample for 48 h under following conditions. Ambient temperature -40 ± 3°C. Leave the sample at the room for 1 to 2 h before check.
		外観 Appearance	異常なきこと Shall remain normal	
5-4-7	温度サイクル Change of temperature	接触抵抗 Contact resistance	20mΩ 以下 20 mΩ or less	コネクタを結合後、下記条件に放置 1. 低温側 -55 ⁺⁰ ₋₃ ℃ 30分 2. 室温 +25 ⁺¹⁰ ₋₅ ℃ 5分以内 3. 高温側 +85 ⁺³ ₋₀ ℃ 30分 4. 室温 +25 ⁺¹⁰ ₋₅ ℃ 5分以内 1～4を25サイクル行う。 Engage the connector, and subject it to 25 cycles of following sequence. 1. Low temperature -55 ⁺⁰ ₋₃ °C for 30 min. 2. Room temperature +25 ⁺¹⁰ ₋₅ °C within 5 min. 3. High temperature +85 ⁺³ ₋₀ °C for 30 min. 4. Room temperature +25 ⁺¹⁰ ₋₅ °C within 5 min.
		外観 Appearance	異常なきこと Shall remain normal	

No.	項目 Item	規格値 Description		試験条件及び方法 Check
5-4-8	耐硫化水素ガス性 Hydrogen sulfide	接触抵抗	20mΩ 以下	コネクタを結合後、下記硫化水素ガス中に放置。 濃度 3 ± 1 p p m 温度 4 0 ± 2 °C 放置時間 9 6 時間 室内で1 ~ 2 時間放置後測定。 Engage the connector, and keep it in hydrogen sulfide for 96 h. Density 3 ± 1 ppm. Temperature 40 ± 2°C. Leave the sample at the room for 1 to 2 h before check.
		Contact resistance	20 mΩ or less	
5-4-9	耐アンモニア性 Ammonia	外観	異常なきこと	コネクタを結合後、下記アンモニア水の入ったデシケータ容器中に放置 濃度 3 % 温度 2 5 °C 容積比 2 5 m l / l 放置時間 8 時間 室内で1 ~ 2 時間放置後測定。 Engage the connector, and keep it in desiccator filled with following aqueous ammonia for 8 h. Concentration 3%. Temperature 25°C. Volume ratio 25 m l / l Leave the sample at the room for 1 to 2 h before check.
		Appearance	ターミナル各部に割れ・ヒビの発生なきこと Terminals shall remain free from scores and cracks	

5-5 半田付性能 (Soldering characteristics)

No.	項目 Item	規格値 Description	試験条件及び方法 Check
5-5-1	はんだぬれ性 Solderability	半田面に半田がムラ無く 全体に付くこと 浸漬面積の95%以上 95% or more of dipped solder side shall be coated uniformly with solder	ウエハーはんだ付部をフラックスに5 ～10秒浸漬後、下記条件のはんだ槽 に浸漬する。 はんだ槽温度 245 ± 5℃ 浸漬時間 3 ± 0.5秒 Dip the soldering section of wafer into flux for 5 to 10 sec, and then into solder tank of 245 ± 5℃ for 3 ± 0.5 sec.
5-5-2	はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	機能を損なう変形・損傷 等のないこと Shall remain free from deformation, damage, etc. adversely affecting the functions	下記はんだ槽にウエハー角ピンはんだ 付部を浸漬する。 はんだ槽温度 260 ± 3℃ 浸漬時間 10 ⁺¹ ₀ 秒 浸漬深さ 1 mm Dip the square pin soldering section by 1 mm into solder tank of 260 ± 3℃ for 10 ⁺¹ ₀ sec.

6. 梱包・表示 (Packing and marking)

6-1 ターミナル (Terminals)

ターミナルはリールに巻き、さらにダンボール箱に梱包して出荷。
表示はリールに型番、数量、ロットNo.を明記したラベルを貼り付ける。

Wind the terminals on reel, and pack it in cardboard case for shipment.
As indications, attach a label filled with product number, quantity and lot
No. onto reel.

6-2 ハウジング・ウエハー (Housings, Wafer)

ナイロン袋に入れ、さらに、ダンボール箱に梱包して出荷。
表示はナイロン袋、ダンボール箱に型番、数量、ロットNo.を明記したラベルを貼り付
ける。

Put the housings in nylon bag, and pack it in cardboard case for shipment.
As indications, attach labels filled with product number, quantity and lot No.
onto nylon bag and cardboard case.







・ラベル Label

<ターミナル・ハウジング>
<Terminal・Housing>

<ウエハー>
<Wafer>

J.A.M. JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.

CATALOG No.	
①	
 	
LOT No.	QUANTITY
②	③
	
NOTE	JOINT
	0 1 2
	【RoHS】

④ MADE IN JAPAN

JAPAN AUTOMATIC MACHINE HONG KONG, LTD. **J.A.M.**

CATALOG NO.	
①	RoHS
LOT NO.	INSPECT
②	⑤
QUANTITY	
③	

④ MADE IN PHILIPPINES

① 製品番号 (Product No.)

② ロット番号 (Lot No.)

0 □ 1 L 1 8 1 0 0 1

通し番号 The through number

型番 Part No.

日付 Date (1日 1st 01... 30日 30th 30)

月 Month (1月 Jan. A ... 12月 dec. L)

年 Year (西暦末尾 The end of A.D)

生産工場 Production factory ※

変化点 Revision

※ 生産工場：A：日本オートマチックマシン（株） 端子事業所（福島県 南相馬市）
又は

△G：フジモールドフィリピン（株）（フィリピン バタンガス）

Production factory：

A：JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO.,LTD TANSHI PLANT (Minamisoma, Fukushima) or

G：FUJIMOLD PHILIPPINES, INC. (Batangas, Philippines)

③ 数量 (Quantity)

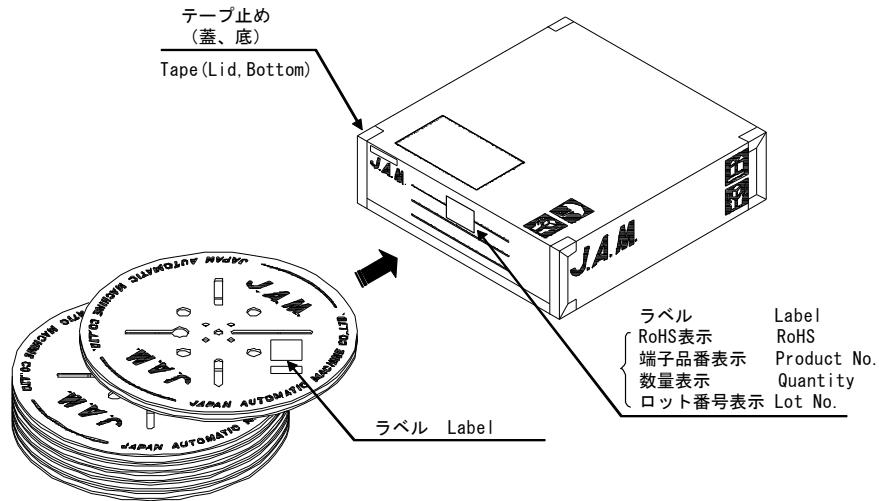
④ 原産国 (Country of origin)：日本 (Japan)又はフィリピン (Philippines)

⑤ 梱包確認印 (Inspect)

△ 7. 梱包数量 (Packing Quantity)

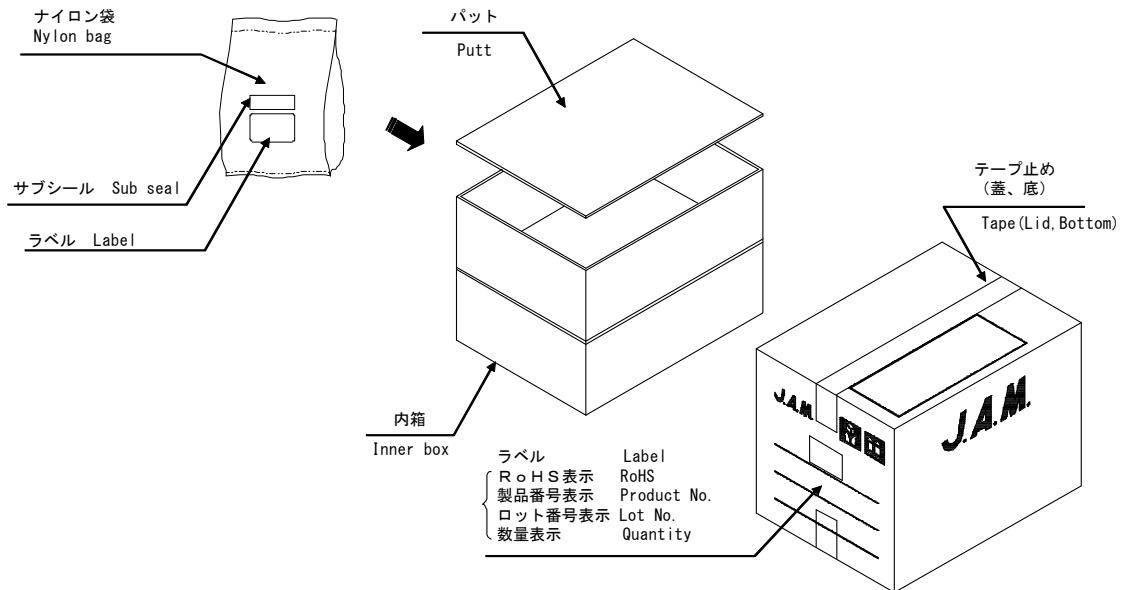
7-1 ターミナル (Terminals)

製品番号 Product number	1リール数量 Pieces /Reel	1箱リール数 Reels/1 Box	1箱数量 Pieces/Box	製品質量 Mass
742766-2MAC	5,000	6	30,000	0.1407g



7-2 ハウジング (Housings)

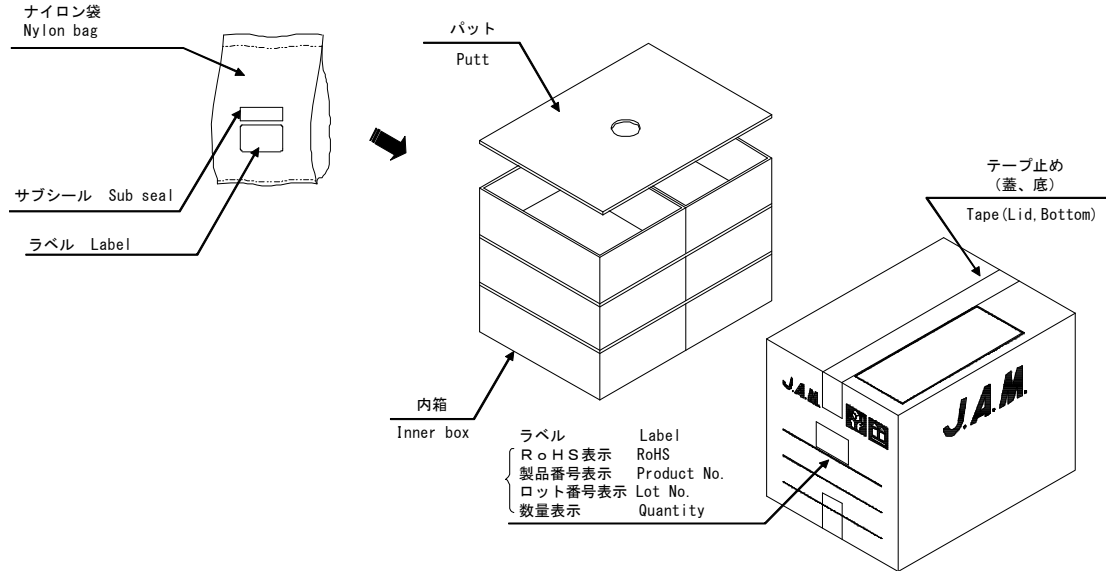
製品番号 Product number	1袋数量 Pieces/bag	1箱袋数 Bags/Box	内箱投入数 Number of inner box	1箱数量 Pieces/Box	製品質量 Mass
SFP79-02HG	1,000	6	2	12,000	0.480g
SFP79-02HGN	1,000	6	2	12,000	0.495g



※ SFP79-02HGNのナイロン袋・ラベルは青色です。
The nylon bag and label of "SFP79-02HGN" are blue.

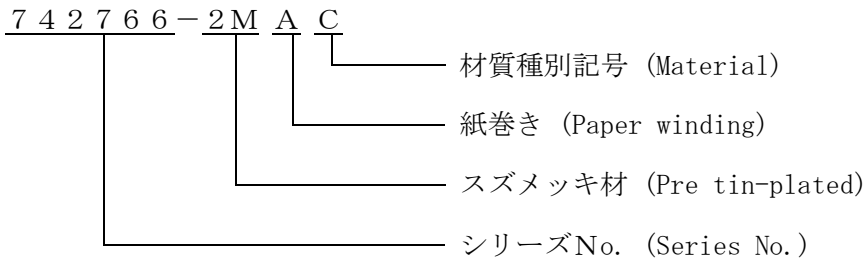
7-3 ウエハー (Wafer)

製品番号 Product number	1袋数量 Pieces/bag	1箱袋数 Bags/Box	内箱投入数 Number of inner box	1箱数量 Pieces/Box	製品質量 Mass
SFP79-02WLB	500	3	6	9,000	0.744g

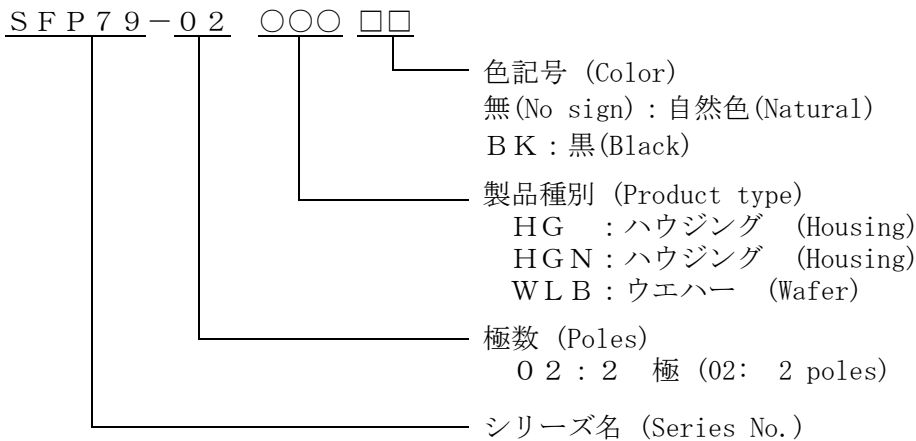


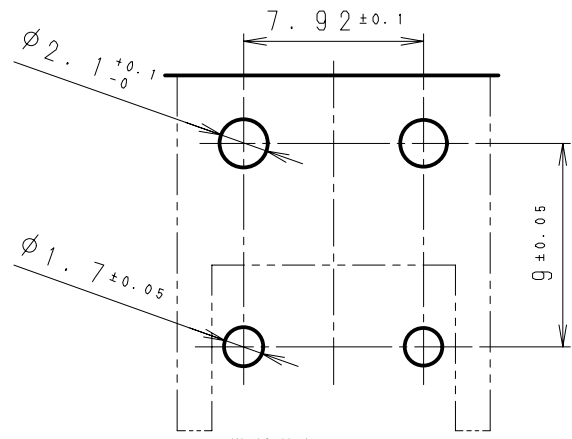
品番構成 (Product No. code)

<ターミナル> <Terminal>

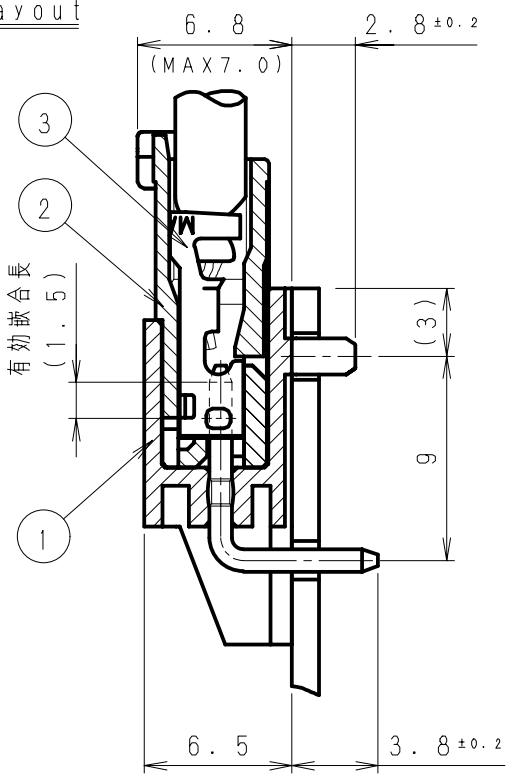
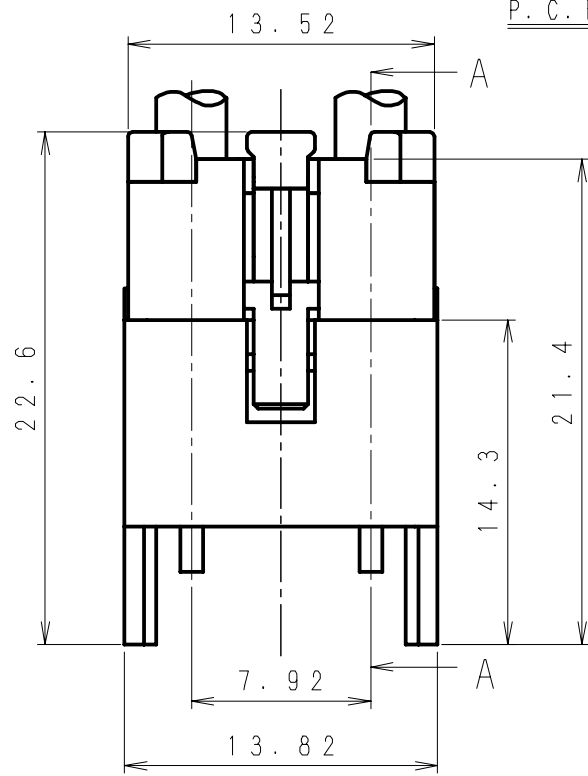


<ハウジング・ウエハー> <Housing and Wafer>





推奨基板レイアウト
P. C. B. Layout

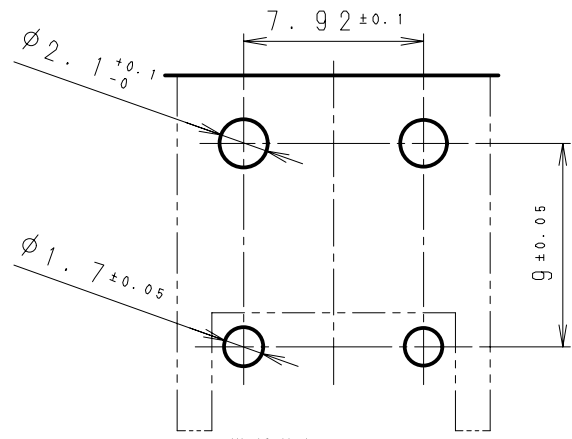


A - A

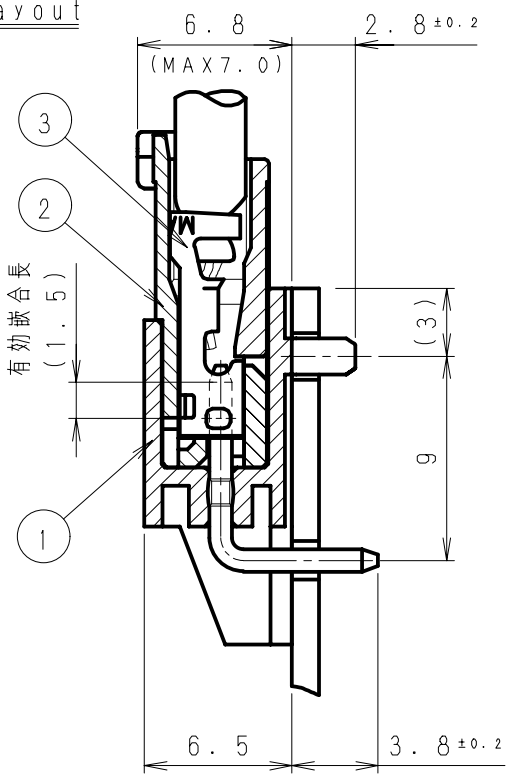
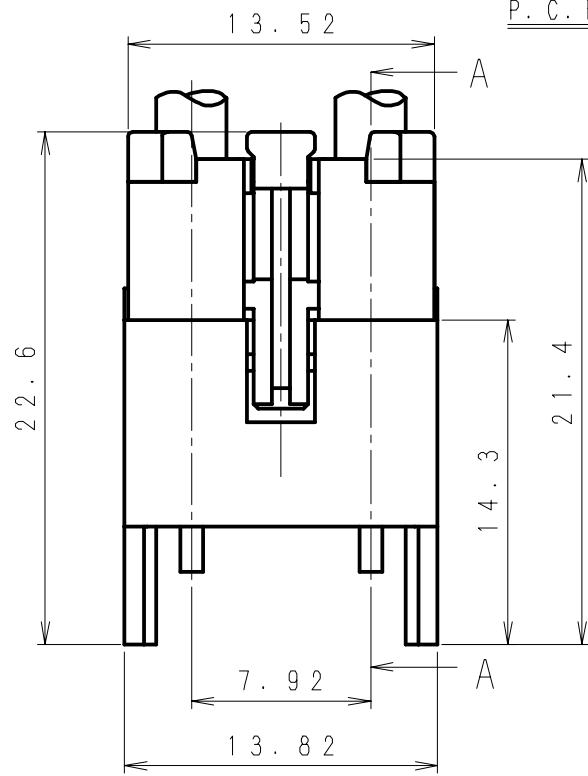
No.	製品番号 Product No.	製品名 Product Name	材質 Material
①	SFP79-02WLB□□	ウエハ Wafer	ナイロン66 GF入り Nylon 66 with GF 黄銅 (スズメッキ) Brass (Tin Plating)
②	SFP79-02HG□□	ハウジング Housing	ナイロン66 Nylon 66
③	742766-2MAC	ソケットコンタクト Socket Contact	銅合金 (スズメッキ材) COPPER ALLOY (Pre-tin Plated)

極数 Poles	2
適用電線 Wire Size	AWG#16~#20
被覆外径 Insulation Dia.	MAXφ3.3mm
適用プリント基板 Applicable P.C.B. Thickness	厚さ 1.2mm, 1.6mm

△3	製品番号 PRODUCT No.	No.	材 料 MATERIAL	備考 NOTE	色 COLOR
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	製品名 NAME		SFPコネクタ DIPタイプ SFP Connector DIP-type		
承認 APPROVED	確認 CHECKED		一般公差 TOLERANCE		尺度 SCALE	図番 DRAWING No.			
K. Kusano		K. Koizumi		±0.3		3/1		JC-1066-32	
設計 DESIGN		製図 DRAWING							
N. Nemoto		Y. Shimizu							



推奨基板レイアウト
P. C. B. Layout

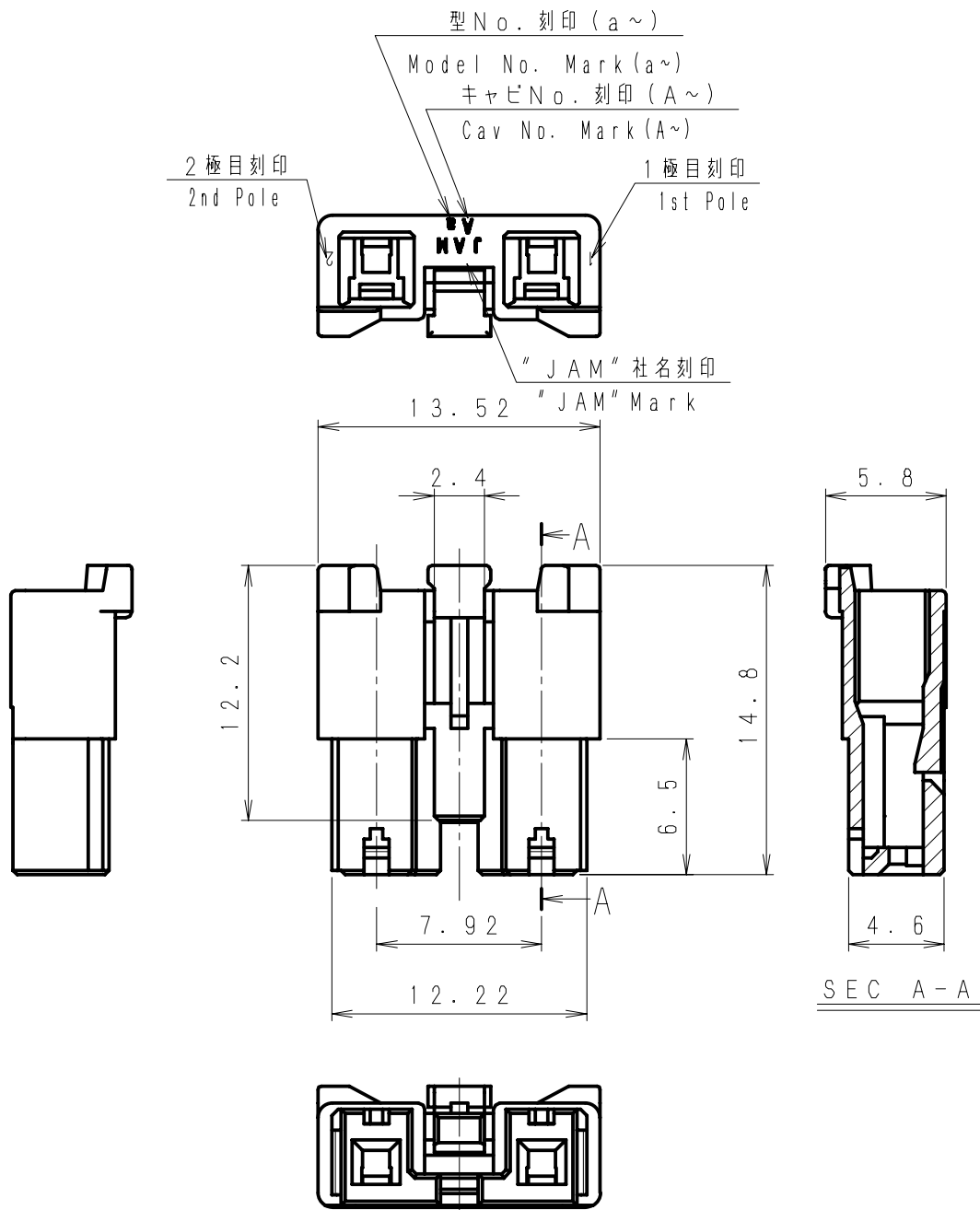


A - A

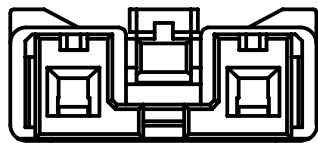
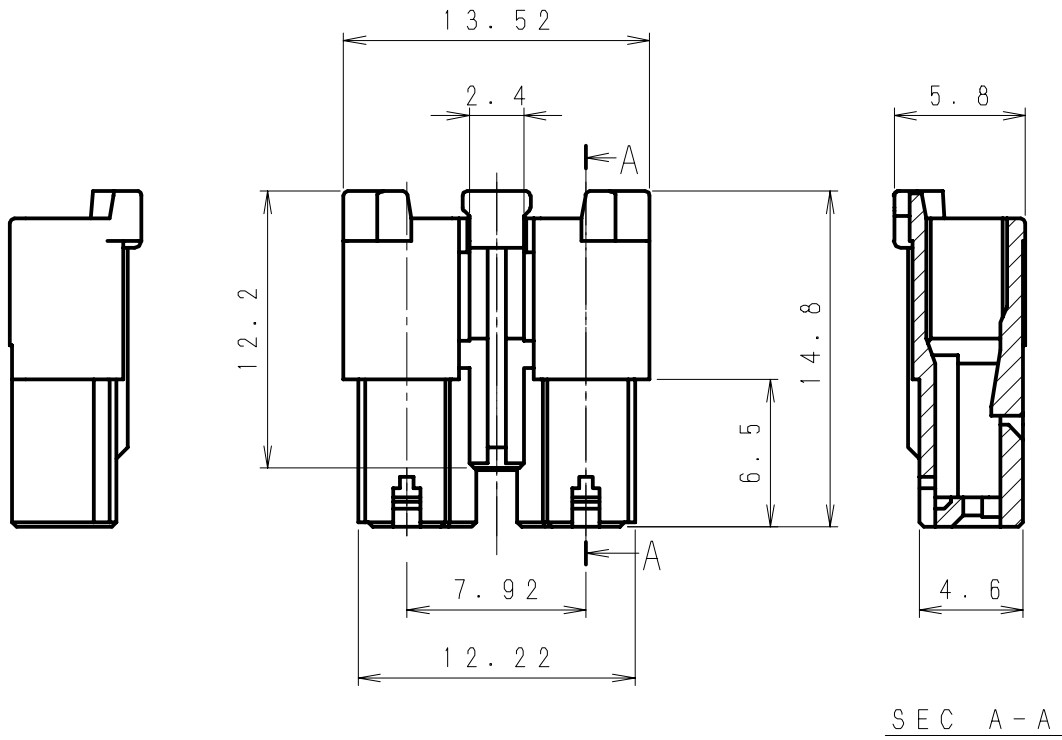
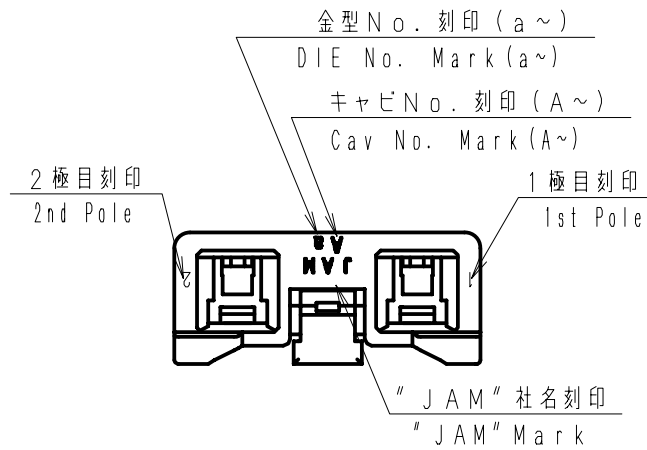
No.	製品番号 Product No.	製品名 Product Name	材質 Material
①	SFP79-02WLB□□	ウエハ Wafer	ナイロン66 GF入り Nylon 66 with GF 黄銅(スズメッキ) Brass(Tin Plating)
②	SFP79-02HG□□	ハウジング Housing	ナイロン66 Nylon 66
③	742766-2MAC	ソケットコンタクト Socket Contact	銅合金(スズメッキ材) COPPER ALLOY(Pre-tin Plated)

極数 Poles	2
適用電線 Wire Size	AWG#16~#20
被覆外径 Insulation Dia.	MAXφ3.3mm
適用プリント基板 Applicable P.C.B. Thickness	厚さ 1.2mm, 1.6mm

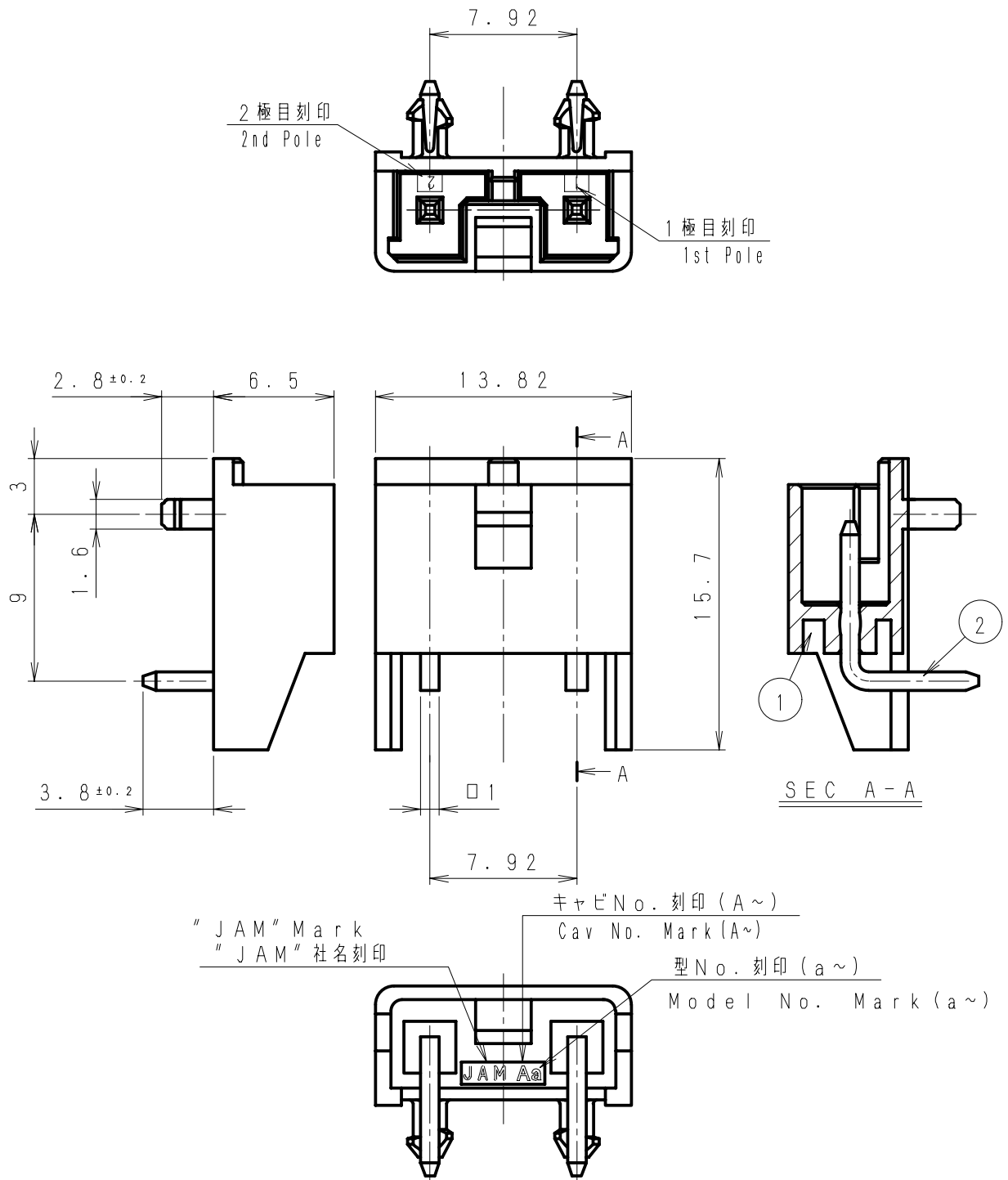
△3	製品番号 PRODUCT No.	No.	材 料 MATERIAL	備考 NOTE	色 COLOR
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	製品名 NAME		SFPコネクタ DIPタイプ SFP Connector DIP-type		
承認 APPROVED	確認 CHECKED		一般公差 TOLERANCE		尺度 SCALE	図番 DRAWING No.			
K. Kusano		K. Koizumi		±0.3		3/1		JC-1066-33	
設計 DESIGN		製図 DRAWING		JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.					
N. Nemoto		Y. Shimizu							



④	. .				△ SFP79-02HG□□	ナイロン66 (UL94 V-0) Nylon 66 (UL94 V-0)		△ 自然色・黒 Natural-Black
③	. .				製品番号 PRODUCT No.	材 料 MATERIAL	備考 NOTE	色 COLOR
②	. .							
①	'11. 9. 1	色アイテム追加 (黒) Item add (Black)	清水	草野				
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	製品名 NAME		SFPハウジング SFP Housing	
承認 APPROVED	K. Kusano		確認 CHECKED	K. Koizumi		一般公差 TOLERANCE	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.
±0.3		3/1		JC-1066-09				
設計 DESIGN	N. Nemoto		製図 DRAWING	N. Nemoto		JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.		



④	. .				SFP79-02HGND□	ナイロン66 (UL94 V-0) Nylon 66 (UL94 V-0)		自然色・黒 Natural-Black
③	. .				製品番号 PRODUCT No.	材 料 MATERIAL	備考 NOTE	色 COLOR
②	. .							
①	. .							
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	製品名 NAME		SFPハウジング SFP Housing	
承認 APPROVED	確認 CHECKED		一般公差 TOLERANCE		尺度 SCALE	図番 DRAWING No.		
K. Kusano		K. Koizumi		±0.3		3 / 1		
設計 DESIGN		製図 DRAWING		JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.				
N. Nemoto		Y. Shimizu						

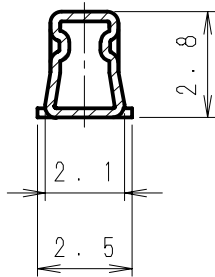
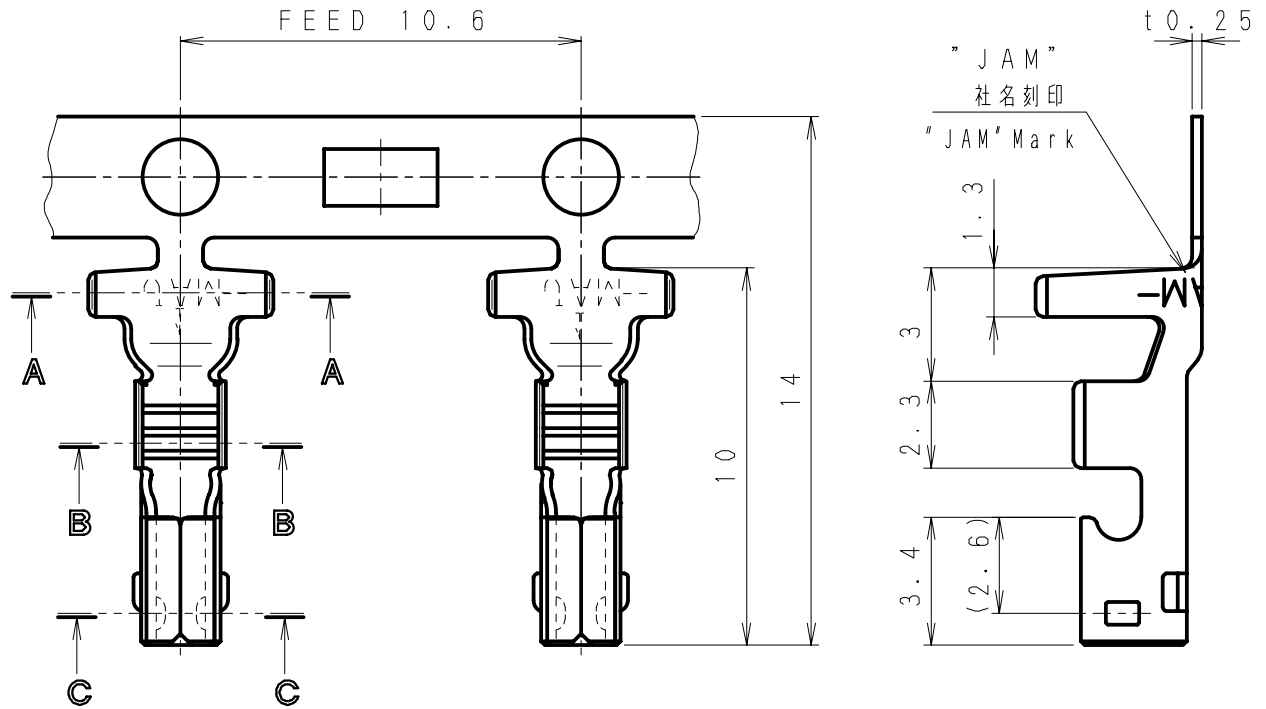


△5						②	黄銅 Brass	スズメッキ Tin Plating	
△4					SFP79-02WLB00	①	ナイロン66 (UL94 V-0) Nylon 66 (UL94 V-0)	GF入り With GF	自然色・黒 Natural-Black
△3									
△2					製品番号 PRODUCT No.	No.	材 料 MATERIAL	備 考 NOTE	色 COLOR
△1									
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP			製品名 NAME	SFP ウエハー DIPタイプ SFP Wafer DIP-type	
承認 APPROVED	K. Kusano	確認 CHECKED	K. Koizumi	一般公差 TOLERANCE	±0.3	尺度 SCALE	3/1	図番 DRAWING No.	JC-1066-35
設計 DESIGN	N. Nemoto	製図 DRAWING	Y. Shimizu	JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.					

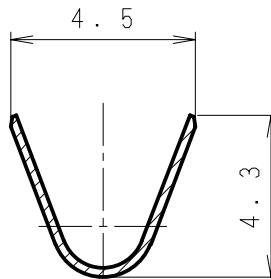
第三角法
3rd ANGLE PROJECTION

単位: mm
UNIT: mm
注) 図面を実測しないこと
NOTES) DO NOT SCALE

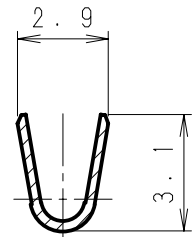
図番 DRAWING No.
JC-1066-11



SEC C-C



SEC A-A



SEC B-B

④	. . .				742766-2MAC	銅合金 COPPER ALLOY	スズメッキ材 Pre-tin Plated	AWG#16~#20	MAX φ3.3
③	. . .				製品番号 PRODUCT No.	材 料 MATERIAL	表面処理 FINISH	適用電線 WIRE SIZE	被覆外径 INSULATION DIA
②	. . .				記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP
①	. . .				製品名 NAME	ソケット コンタクト Socket Contact			
承認 APPROVED K. Kusano		確認 CHECKED K. Koizumi		一般公差 TOLERANCE ±0.3	尺度 SCALE 5/1	図番 DRAWING No. JC-1066-11			
設計 DESIGN N. Nemoto		製図 DRAWING N. Nemoto		JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.					